

海通证券股份有限公司

关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司

2022 年度持续督导半年度跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：盛美上海
保荐代表人姓名：张博文、李凌	被保荐公司代码：688082

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2689号）核准，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）于2021年11月18日首次公开发行A股43,355,753股，每股的发行价为人民币85.00元，募集资金总额为人民币368,523.90万元，扣除发行费用人民币20,398.05万元（不含税，下同）后，实际募集资金净额为人民币348,125.85万元。上述募集资金净额已全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZI10561号《验资报告》予以确认。本次发行证券已于2021年11月18日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2021年11月18日至2024年12月31日。

在2022年1月1日至2022年6月30日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就2022年半年度持续督导情况报告如下：

一、2022 年半年度保荐机构持续督导工作情况

项目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应

计划。	的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易日内向上海证券交易所报告，并说明原因。	保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导期间，未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况。
3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经审核后予以披露。	本持续督导期间，上市公司未发生需公开发表声明的违法违规事项。
4、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个交易日内向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，上市公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
5、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式，对上市公司开展持续督导工作。其中，保荐机构于2022年7月11日及2022年7月25日对上市公司进行了现场检查。
6、督促上市公司建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度。	保荐机构已督促上市公司建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度。
7、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构持续督促、指导上市公司及其董事、监事、高级管理人员，本持续督导期间，上市公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。
8、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	核查了上市公司治理制度建立与执行情况，上市公司《公司章程》、三会议事规则等制度符合相关法规要求，本持续督导期间，上市公司有效执行了相关治理制度。
9、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	核查了上市公司内控制度建立与执行情况，上市公司内控制度符合相关法规要求，本持续督导期间，上市公司有效执行了相关内控制度。
10、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促上市公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。

<p>11、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。</p>
<p>12、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。</p>
<p>13、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。</p>
<p>14、关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，应及时向上海证券交易所报告。</p> <p>上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。</p> <p>保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。</p> <p>上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。</p> <p>上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。</p>
<p>15、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。</p>
<p>16、发现以下情形之一的，应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：</p> <p>（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>

<p>(二) 中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；</p> <p>(三) 上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；</p> <p>(四) 上市公司不配合保荐机构持续督导工作；</p> <p>(五) 上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。</p>	
<p>17、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。保荐机构对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次，负责该项目的两名保荐代表人至少应有一人参加现场检查。</p>	<p>保荐机构制定了对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求。保荐机构于2022年7月11日及2022年7月25日对上市公司进行了现场检查，负责该项目的两名保荐代表人有1人参加了现场检查。</p>
<p>18、重点关注上市公司是否存在如下事项：</p> <p>(一) 存在重大财务造假嫌疑；</p> <p>(二) 控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；</p> <p>(三) 可能存在违规担保；</p> <p>(四) 控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；</p> <p>(五) 资金往来或者现金流存在重大异常；</p> <p>(六) 本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。</p> <p>出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当督促公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道之日起15日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的，保荐机构应当及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。</p>
<p>19、识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>20、关注上市公司股票交易异常波动情况，督促上市公司按照本规则规定履行核查、信息披露等义务。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>21、对上市公司存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>22、上市公司日常经营出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：</p> <p>(一) 主要业务停滞或出现可能导致主要业务</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>

<p>停滞的重大风险事件；</p> <p>(二) 资产被查封、扣押或冻结；</p> <p>(三) 未能清偿到期债务；</p> <p>(四) 实际控制人、董事长、总经理、财务负责人或核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；</p> <p>(五) 涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项；</p> <p>(六) 本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	
<p>23、上市公司业务和技术出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：</p> <p>(一) 主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化；</p> <p>(二) 核心技术人员离职；</p> <p>(三) 核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷；</p> <p>(四) 主要产品研发失败；</p> <p>(五) 核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现具有明显优势的竞争者；</p> <p>(六) 本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>24、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。</p>	<p>保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议，于 2022 年 7 月 11 日及 2022 年 7 月 25 日对上市公司募集资金存放与使用情况进行了现场检查，并出具关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告。</p>
<p>25、上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员是否存在未依法规范运作，未切实保障投资者的合法权益，侵害投资者利益的情况。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>26、保荐机构发表核查意见情况。</p>	<p>本持续督导期间，保荐机构发表核查意见具体情况如下：</p> <p>2022 年 3 月 1 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；</p> <p>2022 年 3 月 1 日，保荐机构发表《海通证券股</p>

	<p>份有限公司关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；</p> <p>2022 年 3 月 1 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司确认 2021 年度日常关联交易超出预计部分及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》；</p> <p>2022 年 3 月 1 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2021 年度持续督导跟踪报告》；</p> <p>2022 年 3 月 1 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2021 年度持续督导现场检查报告》；</p> <p>2022 年 5 月 9 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。</p>
27、保荐机构发现的问题及整改情况（如有）。	无

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

海通证券持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）技术更新风险

公司所处的半导体专用设备行业属于技术密集型行业，涉及微电子、电气、机械、材料、化学工程、流体力学、自动化、图像识别、通讯、软件系统等众多

学科领域，具有较高的技术研发门槛。随着全球半导体行业的蓬勃发展，半导体行业技术日新月异，清洗设备对晶圆表面污染物的控制要求越来越高，以避免杂质影响芯片良率和产品性能。此外，客户对清洗设备清洗表面污染物的种类、清洗效率、腔体数量、适用技术节点等需求也随之不断变化。公司长期坚持差异化竞争和创新的发展战略，若不能继续保持充足的研发投入，亦或芯片工艺节点继续缩小，再或芯片制造新技术的出现，都可能导致公司的 SAPS、TEBO、Tahoe 等核心技术及相关产品的先进程度下降，将可能对公司的经营业绩造成不利影响。

（二）关键技术人才流失风险

作为技术密集型行业，技术人才是决定半导体专用设备行业竞争力的关键因素。随着中国大陆半导体专用设备行业的持续发展，对技术人才的竞争将不断加剧。如果由于薪酬或其他原因，公司的关键技术人才大量流失，或者公司无法激励现有技术人才，亦或无法吸引优秀技术人才，公司可能发生技术团队配置不足的情形，从而无法继续研发和销售新产品，无法为客户提供优质的服务，公司也可能会面临更高的招聘及培训成本，将对公司技术研发能力和经营业绩造成不利影响。

（三）核心技术泄密风险

公司自身几乎不从事零部件加工业务，而是根据对产品的设计组织零部件外购及外协。公司一向重视对核心技术的保护，但如果因公司或供应商的网络安全系统无法防范未经授权的访问、复杂的网络攻击，或者公司的员工、供应商对敏感数据的不当处理等原因导致公司的知识产权、核心技术泄露，公司可能会受到客户的重大责任索赔，将可能导致公司的声誉和竞争地位受到严重损害，进而对公司的业务发展和经营成果产生不利影响。

（四）市场竞争风险

全球半导体专用设备行业市场竞争激烈，市场主要被国际巨头企业所占据，公司产品在其面向的市场均与国际巨头直接竞争。与中国大陆半导体专用设备企业相比，国际巨头企业拥有更强的资金实力、技术储备、销售团队、制造能力、销售渠道和市场知名度，拥有更广泛的客户和合作伙伴关系，也拥有更长的经营

历史、更为丰富的产品系列、更为广泛的地域覆盖，能够更好地识别和应对市场和客户需求的变化。部分国际巨头还能为同时购买多种产品的客户提供捆绑折扣。

近年来随着中国半导体终端应用市场的不断增长，中国半导体制造、封测、材料、设备等子行业的发展迅速。伴随着全球半导体产业第三次转移的进程，中国大陆市场预计将成为全球半导体设备企业竞争的主战场，公司未来将面临国际巨头企业和中国新进入者的双重竞争。公司产品与国际巨头相比，在适用技术节点、市场占有率等方面有一定的差距，如果公司无法有效应对与该等竞争对手之间的竞争，公司的业务收入、经营成果和财务状况都将受到不利影响。

（五）对部分关键零部件供应商依赖的风险

目前，公司设备中使用的部分关键零部件依赖于公司当前的供应商，比如：**Product Systems, Inc.**为公司单片清洗设备关键零部件兆声波发生器的唯一供应商；**NINEBELL**为公司单片清洗设备传送系统中机器人手臂的主要供应商；**Advanced Electric Co., Inc.**为公司单片清洗设备中阀门的关键供应商。如果公司与该等供应商的合作关系发生不利变化，或该等供应商自身经营出现困难，将对公司的生产计划产生不利影响；若公司更换该等关键零部件的采购来源，可能会在过渡阶段出现供应中断，导致公司产品延迟交货，并产生高额费用，进而可能对公司的经营业绩产生不利影响。

（六）市场开拓失败风险

公司的市场开拓策略是首先开拓全球半导体龙头企业客户，通过长时间的研发和技术积累，取得其对公司技术和产品的认可，以树立公司的市场声誉。然后凭借在国际行业取得的业绩和声誉，持续开拓中国大陆等半导体行业新兴区域市场。公司通过向客户展示 **SAPS**、**TEBO**、**Tahoe** 技术、电镀设备和无应力抛光设备的差异化和创新性，立式炉管系列产品的性能及可靠性，使全球领先的芯片制造企业能够评估和验证公司的技术和产品。在公司的市场开拓过程中，如果这些领先的芯片制造企业不愿接受和验证公司的设备产品；或者即使这些领先的芯片制造企业采用公司的技术和设备，其他芯片制造企业也可能不会接受公司的技术和设备。公司产品的市场开拓存在失败的风险，可能会对公司的业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响。

公司产品的销售周期可能非常漫长，并且具有不确定性。从最初与客户接触到执行采购订单，公司的销售周期一般是 6 到 24 个月甚至更长。公司很难准确预测潜在客户何时、甚至是否会向公司采购，也很难准确预测公司是否能够增加对现有客户的销售。在销售周期内，公司在营销活动将投入大量的时间和资金，会对公司的经营成果及财务状况造成一定不利影响。

此外，在公司发展的前期，业务规模较小，难以覆盖众多潜在客户，公司主要通过代理商开拓市场。随着公司业务规模的不断扩大，公司开始着手扩大自身销售团队。若代理商和公司自有销售团队未能持续开拓新客户，或者代理商选择不再与公司继续合作，都将对公司的业务和经营成果产生不利影响。

（七）税收优惠风险

2022 年 1-6 月，公司享受高新技术企业所得税的税收优惠和研发费用加计扣除。如果中国有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得中国高新技术企业资格或不满足研发费用加计扣除的条件等，将对公司的经营业绩造成一定影响。

（八）汇率波动风险

2022 年 1-6 月，公司的大多数产品销售以美元计价，部分原材料、零部件采购以美元和韩元计价，而其他原材料、零部件、员工薪酬、其他成本费用以人民币计价，人民币对美元、韩元的汇率将会对公司的经营成果造成影响。人民币汇率随着国际政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。随着公司业务规模的持续扩大，若未来人民币对美元、韩元的汇率发生剧烈波动，将对公司的业绩带来一定的不确定性，可能导致汇兑损失的产生，从而对公司的经营成果和财务状况造成不利影响。

（九）行业风险

公司所处的半导体专用设备行业是半导体产业链的关键性支撑行业，其需求直接受到芯片制造、封测行业及终端应用市场的影响。

如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致 5G 通信、计算机、消费电子、网络通信、汽车电子、物联网等终端市场需求下降，晶圆制造、封测企业将面临产能

过剩的局面，从而导致芯片产品销量和价格的下降，其营业收入、盈利能力也将随之下降。晶圆制造、封测企业通常会在行业低迷期间大幅削减资本性支出，而且资本性支出的下降幅度往往会超过其营业收入的下降幅度，从而削减对半导体专用设备的采购金额，将会对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。

而在半导体行业景气度提升的周期，公司必须提高产量以满足预期的客户需求，这要求公司及供应商增加库存、扩大生产能力。如果公司不能及时应对客户需求的快速增长，或者对需求增长的期间、持续时间或幅度判断错误，一方面公司可能会失去现有客户，另一方面也可能发生与营业收入增长不成比例的成本增加，进而可能会对公司的业务、经营成果、财务状况或现金流量产生重大不利影响。

（十）宏观环境风险

2018年以来，美国和中国之间的贸易争端有所加剧。在2018年7月、8月和9月、2019年6月和9月以及2020年2月，美国政府对原产于中国的特定进口产品征收关税。中国政府也通过对从美国进口的特定产品征收关税来应对每一轮美国关税变动。未来，美国和中国政府仍将可能对原产于对方的特定产品继续加征关税，或设置其他贸易壁垒。

美国和中国政府加征关税以及周边的经济不确定性可能会对半导体行业产生负面影响，包括降低晶圆制造、封测企业对半导体专用设备的需求。如果所在国贸易政策、关税、附加税、出口限制或其他贸易壁垒进一步恶化，将可能对公司客户的生产或销售能力造成不利影响，使公司客户的经营状况恶化，导致客户对公司设备产品的需求降低。此外，如果中国政府对公司从美国采购的原材料或零部件加征关税，公司的经营成本也将增加，进而会对公司的营业收入、经营成果或财务状况产生重大不利影响。

四、重大违规事项

2022年1-6月，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022年1-6月，公司主要财务数据情况如下：

单位：万元

主要会计数据	2022年1-6月	2021年1-6月	本期比上年同期增减(%)
营业收入	109,553.22	62,528.08	75.21
归属于上市公司股东的净利润	23,658.85	8,967.60	163.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,742.42	4,885.66	426.90
经营活动产生的现金流量净额	-32,761.02	4,093.21	-900.37
主要会计数据	2022年6月30日	2021年6月30日	本期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	506,763.36	481,496.11	5.25
总资产	669,745.71	633,741.34	5.68

2022年1-6月，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	2022年1-6月	2021年1-6月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.55	0.23	139.13
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.23	134.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.59	0.13	353.85
加权平均净资产收益率(%)	4.80	8.20	减少3.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.22	4.47	增加0.75个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	17.05	18.33	减少1.28个百分点

上述主要财务数据和财务指标的变动原因如下：

2022年1-6月公司营业收入为10.96亿元，同比增长75.21%，主要原因是全球半导体行业景气以及市场对公司半导体设备的强劲需求，公司销售订单及产能均持续增长，营业收入进一步提升。公司继续产品多元化的发展策略，新产品的强劲增长使收入结构多样化并扩大了市场规模。公司2022年1-6月半导体清洗设备、前道半导体电镀设备和先进封装湿法设备（包含后道电镀设备）的营业收入均有较大增长。

2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长163.83%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长426.90%，主要原因是公司主营业务收入增长。

2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-3.28亿元，同比下降主要是销售订单增长引起的本期购买原材料支付的现金较上期增加以及支付职工薪酬较上期增长所致。

2022年1-6月基本每股收益0.55元，较上年同期增长139.13%；稀释每股收益0.54元，较上年同期增长134.78%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.59元，较上年同期增长353.85%。主要原因是公司主营业务收入增长。

六、核心竞争力的变化情况

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，公司兆声波单片清洗设备、单片槽式组合清洗设备及铜互连电镀工艺设备与国内及国际同行业企业的差别及核心竞争力体现的具体情况如下：

项目	盛美上海	中国同行业企业	国际巨头
兆声波单片清洗设备			
技术特点	通过控制兆声波发生器和晶圆之间的半波长相对运动，实现晶圆表面兆声波能量的均匀分布，解决了传统兆声清洗中由于晶圆翘曲引起的兆声波清洗不均一的难题；通过精确控制兆声波的输出方式，使气泡在受控的温度下保持一定尺寸和形状的振荡，将气泡振荡控制在稳定空化状态而不会产生内爆或塌陷，解决了传统兆声波清洗过程中由于气泡爆裂而引起的图形损伤问题。	主要为二流体清洗技术	主要采用化学液体清洗配合氮气雾化水物理清洗
技术节点及所覆盖下游行业	SAPS技术目前已应用于逻辑28nm技术节点及DRAM 19nm技术节点，并可拓展至逻辑芯片14nm、DRAM 17/16nm技术节点、32/64/128层3D NAND、高深宽比的功率器件及TSV深孔清洗应用，在DRAM上有70多步应用，而在逻辑电路FinFET结构清洗中有近20步应用；TEBO技术主要针对45nm及以下图形晶圆的无损伤清洗，目前已应用于逻辑芯片28nm技术节点，已进行16-19nm DRAM工艺图形晶圆的清洗工艺评估，并可拓展至14nm逻辑芯片及nm级3D FinFET结构、高深宽比DRAM产品及多层堆叠3D NAND等产品中，在DRAM上有70多步应用，而在逻辑电路FinFET结构清洗中有10多步应用。	相比公司，其清洗设备技术节点较落后、应用领域较窄	相比公司，其已销售的清洗设备应用于5nm及以上生产线、应用领域更广
晶圆尺寸	12英寸为主，也可用于8英寸功率器件的深沟槽清洗	无明显差异	无明显差异
市场占有率	中国市场较高，国际市场较低	中国市场较低	中国市场较高，国际市场垄断

单片槽式组合清洗设备			
技术特点	相比当前主流单片设备，可大幅减少硫酸使用量；保持湿润及一定水膜厚度传送硅片至单片清洗模块；在单片清洗模块中进行晶圆最终清洗，清洗能力优于传统槽式清洗设备，可和单片清洗设备相媲美。	-	-
技术节点及所覆盖下游行业	应用包括前段干法蚀刻后聚合物及残胶去除，抛光后研磨液残留物去除，离子注入后光刻胶残留物去除，通孔前有机残留物去除等工艺，目前已完成逻辑芯片逻辑40nm及28nm技术节点产线验证，并可拓展至14nm逻辑芯片、20nm DRAM及以上技术节点及64层及以上3D NAND，可用于20步及以上的清洗高温硫酸及高温磷酸的清洗步骤。	无此产品	无此产品
晶圆尺寸	12英寸为主	无此产品	无此产品
市场占有率	中国市场较低	无此产品	无此产品
铜互连电镀工艺设备			
技术特点	利用多阳极局部电镀技术，采用精确可控电源分别接通各个阳极，实现局部电镀，适用于超薄种子层覆盖小孔及沟槽结构的无空穴电镀填充；独立电镀液流场控制系统，单独控制向各个阳极提供电镀液，精确控制电镀腔内的流体场；电镀夹具密封技术，通过全封闭式密封圈对接触电极的保护，提高工艺性能和延长接触电极使用寿命，降低工艺耗材成本；工艺腔体模块化设计，提升设备有效运行时间。	-	采用虚拟阴极电镀技术，克服晶圆边缘效应，提高晶圆内电镀均匀性；配合智能入水功能，降低入水造成的电镀沉积缺陷。
技术节点及所覆盖下游行业	双大马士革铜互连结构铜电化学沉积工艺： 55nm至14nm及以上技术节点；先进封装凸块、再布线、硅通孔、扇出工艺的电化学镀铜、镍、锡、银、金等。	无此产品	双大马士革铜互连结构铜电化学沉积工艺： 55nm至7nm及以上技术节点；支持5nm及以下技术节点在其他材料上电镀沉积铜。
晶圆尺寸	12英寸为主，也可用于8英寸铜工艺的应用	无此产品	无明显差异
市场占有率	中国市场低	无此产品	市场垄断

公司通过差异化的创新和竞争，成功研发出全球首创的 SAPS/TEBO 兆声波清洗技术和单片槽式组合清洗技术。目前，公司的半导体清洗设备主要应用于 12 英寸的晶圆制造领域的清洗工艺，在半导体清洗设备的适用尺寸方面与国际

巨头公司的类似产品不存在竞争差距。本持续督导期间，未发生导致公司核心竞争力受到严重影响的事件。

七、研发支出变化及研发进展

单位：万元

项目	本年度	上年度	变化幅度
费用化研发投入	15,343.34	11,460.28	33.88
资本化研发投入	3,332.95	-	不适用
研发投入合计	18,676.29	11,460.28	62.97
研发投入总额占营业收入比例（%）	17.05	18.33	减少1.28个百分点
研发投入资本化的比重（%）	17.85	-	增加17.85个百分点

2022年1-6月研发投入总额为1.87亿元，较上年同期研发投入总额增长62.97%。主要是随着现有产品改进及工艺开发以及新产品及新工艺开发，研发测试等服务费增加，聘用的研发人员人数以及支付研发人员的薪酬增加。

截至2022年6月30日，公司及控股子公司拥有已获授予专利权的主要专利368项，其中境内授权专利161项，境外授权专利207项，其中发明专利共计363项。该等在中国境内已授权的专利不存在质押、司法查封等权利受限制的情形。

项目	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	24	21	804	363
实用新型专利	-	-	3	3
外观设计专利	-	-	3	2
软件著作权	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	24	21	810	368

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人募集资金专户余额为人民币 250,653.36 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
2021年募集资金结余金额	283,037.46
减：本报告期募集资金使用金额	11,557.23
减：手续费	3.34
减：发行费用	343.68
减：以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用置换额	21,783.97
加：利息收入	1,304.12
募集资金结余金额	250,653.36

截至 2022 年 6 月 30 日，公司的募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	存储方式	余额
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121909929210918	存款	60,092.36
中国光大银行股份有限公司上海昌里支行	36750180808738885	存款	19,803.13
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	452082279585	存款	3.16
上海银行股份有限公司张江支行	03004750062	存款	45.87
招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	121909929210858	存款	20,013.01
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801900002063	存款	30,546.37
招商银行股份有限公司上海淮海支行	121909929210202	存款	29,668.21
兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100156371	存款	30,162.99
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000444066	存款	30,061.58
中国工商银行股份有限公司上海市滴水湖支行	1001747729300001088	存款	30,225.29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121938866210666	存款	31.40
合计	-	-	250,653.36

公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，

对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2022 年 6 月 30 日，盛美上海控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的盛美上海股份未发生变动，不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2022 年度持续督导半年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 张博文
张博文

李凌
李凌


海通证券股份有限公司
2022年8月5日